

导热绝缘灌封胶

DE-6305 导热绝缘灌封胶适用于对散热性要求高的电子元器件的灌封。该胶固化后导热性能好，绝缘性优，电气性能优异，粘接性好，表面光泽性好。

常规性能

测试项目	测试方法或条件	A 组份	B 组份
外观	目测	白色膏体	褐色透明液体
粘度	A、B 混合后, Mpa.s@25°C		15000
密度	A、B 混合后, g/cm ³		1.9

使用工艺

项目	单位或条件	A/ B
混合比例	重量比	8: 1
可使用时间	小时@25°C, 100 克配胶量	1.5
固化条件	25°C	24 小时初固, 2-7 天完全固化
	80°C	2 小时

注: A、B 组份可能有少量沉淀, 不影响固化性能。使用前将 A、B 组份分别搅拌均匀。A 和 B 组份以重量比 8: 1 混合, 搅拌均匀。抽真空脱去气泡, 最好在真空条件下灌封, 每次配胶量不宜过多, 以配多少用多少为原则。

固化后特性

项目	单位或条件	A/ B
硬度	Shore-D	> 80
抗拉强度	钢/钢, Mpa	25
抗压强度	Mpa	100
体积电阻率	ohm-cm@25°C	1.5x10 ¹⁵
介电强度	KV/mm@25°C	> 15
介电常数	1MHz@25°C	4.2
介电损耗角正切	1MHz @25°C	0.011
导热系数	W/m-k @25°C	1.6

包装、储存及运输

1. 2Kg/套
2. 在原装密封容器中, 室温下至少一年
3. 此类产品为非危险品, 按一般化学品运输

地址: 北京市海淀区阜成路 14 号 3 号楼 218 室 (100037)

TEL: +86-10-68371075/68371012 /68371747/68371561 FAX: +86-10- 68768863

网址: www.reintech.cn E-mail: reintech@163.com